

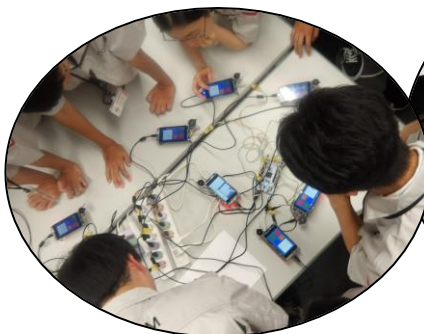
ソフト設計職 インターンシップ

大阪開催

2月17日(火) ~ 2月20日(金)

【内容】

- ・ タッチパネルを使った
C言語による組込ソフト開発体験
- ・ 無線運用体験



【対象者】

2027年卒業予定の方

【会場】

アイコム本社（大阪府平野区）

【交通費】 **全額支給！**

【宿泊場所】 **当社にて準備！**

【応募締切】

2026年1月28日(水)

【応募方法】

QRコードからメールを
送ってご応募ください



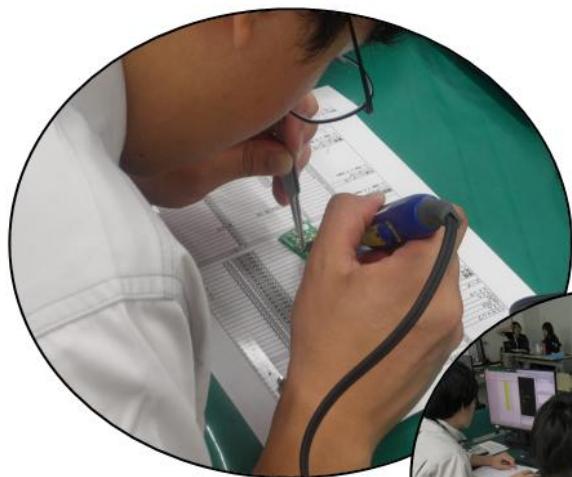
回路設計職 インターンシップ

大阪開催

2月24日(火) ~ 2月27日(金)

【内容】

- ・モノづくり体験
- ・設計業務体験
- ・無線機運用体験



【対象者】

2027年卒業予定の方

【会場】

アイコム本社（大阪府平野区）

【交通費】 **全額支給！**

【宿泊場所】 **当社にて準備！**

【応募締切】

2026年1月28日(水)

【応募方法】

QRコードからメールを
送ってご応募ください

